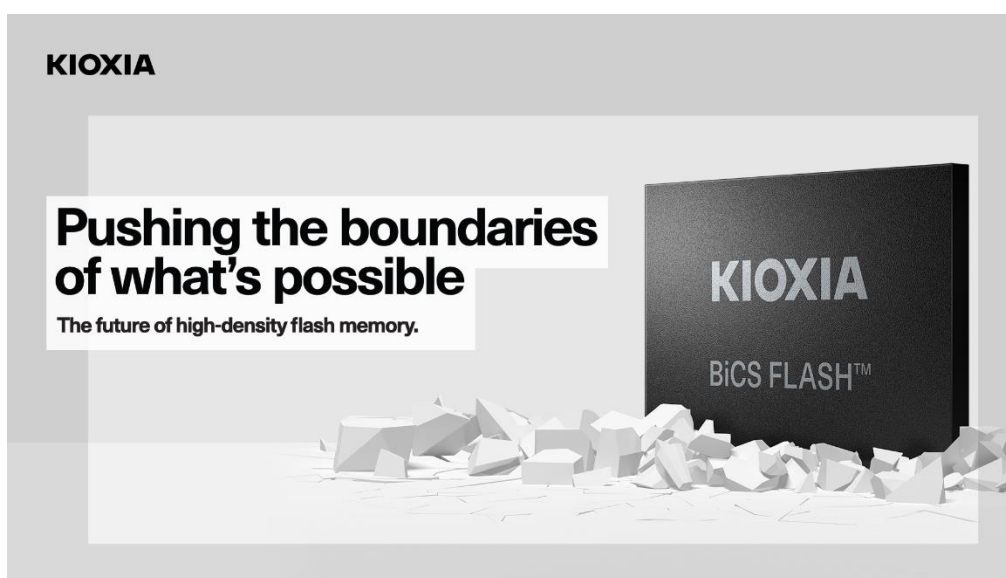


Communiqué de presse

KIOXIA et Western Digital annoncent une nouvelle mémoire flash 3D

Des innovations architecturales révolutionnaires en matière de technologies de mise à l'échelle et de collage des plaquettes de silicium permettent d'améliorer considérablement les performances, la densité et la rentabilité



Düsseldorf, Allemagne, le 31 mars 2023 – [KIOXIA Europe GmbH](#) fait part des récents développements de la coopération entre KIOXIA Corporation et Western Digital Corp. (NASDAQ : WDC) Les entreprises, qui font preuve d'une innovation constante, dévoilent les détails de leur toute dernière technologie de mémoire flash 3D. Grâce à des technologies avancées de mise à l'échelle et de collage de plaquettes, la mémoire flash 3D offre une capacité, des performances et une fiabilité exceptionnelles à un coût avantageux. Elle est ainsi idéale pour répondre aux besoins de la croissance exponentielle des données dans un large éventail de segments de marché.



« La nouvelle mémoire flash 3D démontre les avantages de notre solide partenariat avec KIOXIA et de notre leadership combiné en matière d'innovation », déclare Alper Ilkbahar, vice-président principal de la technologie et de la stratégie chez Western Digital. « En travaillant avec une feuille de route commune et en continuant à investir dans la recherche et le développement, nous avons été en mesure de produire cette technologie fondamentale plus tôt que prévu et de fournir des solutions performantes et économes en capital. »

KIOXIA et Western Digital ont réduit les coûts en mettant en place plusieurs procédés et architectures originaux, ce qui leur a permis de réaliser des progrès continus en matière de mise à l'échelle latérale. Cet équilibre entre la mise à l'échelle verticale et latérale permet d'obtenir une plus grande capacité dans une matrice plus petite, avec moins de couches, à un coût optimisé. Les entreprises ont également mis au point la technologie révolutionnaire CBA (CMOS directly Bonded to Array), dans laquelle les plaquettes CMOS et les plaquettes de réseau cellulaire sont fabriquées séparément dans des conditions optimales, puis collées ensemble pour obtenir une meilleure densité de bits et une vitesse d'entrée/sortie NAND rapide.

« Grâce à notre partenariat d'ingénierie unique, nous avons réussi à lancer la huitième génération de BiCS FLASH™ avec la densité de bits la plus élevée¹ de l'industrie », déclare Masaki Momodomi, directeur de la technologie chez KIOXIA Corporation. « Je suis heureux que les envois d'échantillons de la part KIOXIA vers un nombre limité de clients aient commencé. En appliquant la technologie CBA et les innovations de mise à l'échelle, nous avons fait progresser notre portefeuille de technologies de mémoire flash 3D, en vue d'une utilisation dans une gamme d'applications centrées sur les données, notamment les smartphones, les appareils IoT et les centres de données. »

La mémoire flash 3D à 218 couches s'appuie sur des cellules triple niveau (TLC) et quadruple niveau (QLC) de 1 Tbit avec quatre plans, et présente une technologie innovante de rétrécissement latéral pour augmenter la densité de bits de plus de 50 %. Ses entrées/sorties NAND à grande vitesse de plus de 3,2 Gbit/s, soit une amélioration de 60 % par rapport à la génération précédente, associées à une amélioration de 20 % des performances d'écriture et de la latence de lecture, accéléreront les performances globales et la facilité d'utilisation pour les utilisateurs.

Déclarations prospectives (note aux rédacteurs)

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment des déclarations concernant les attentes en matière de disponibilité, de production, de capacités, de performances, de fiabilité, d'efficacité et d'impact de notre technologie de mémoire flash 3D de nouvelle génération et des produits utilisant cette technologie de mémoire flash 3D de nouvelle génération. Ces déclarations prospectives s'appuient sur les attentes actuelles de la direction et sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les risques et incertitudes importants qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs sont les suivants : la volatilité des conditions économiques mondiales ; les réponses et les effets futurs de la pandémie de COVID-19 ou d'autres crises sanitaires mondiales similaires ; l'impact des conditions commerciales et de marché ; le résultat et l'impact de notre révision stratégique en cours, y compris en ce qui concerne les relations avec les clients et les fournisseurs, les restrictions réglementaires et contractuelles, la volatilité du cours de l'action et le détournement de l'attention de la direction vis-à-vis des opérations et des opportunités commerciales en cours ; l'impact des produits et des prix de la concurrence ; le développement et l'introduction de produits reposant sur de nouvelles technologies et l'expansion sur de nouveaux marchés de stockage de données ; les risques associés aux initiatives de réduction des coûts, aux restructurations, aux acquisitions, aux cessions, aux fusions, aux coentreprises et à nos relations stratégiques ; les difficultés ou retards de fabrication ou autres perturbations de la chaîne d'approvisionnement ; l'embauche et la fidélisation d'employés clés ; notre niveau d'endettement et autres obligations financières ; les changements dans nos relations avec nos clients clés ; les perturbations des opérations dues à des incidents de cybersécurité ou autres risques de sécurité des systèmes ; les actions des concurrents ; les risques liés à la conformité aux exigences légales et réglementaires changeantes et à l'issue des procédures judiciaires ; et d'autres risques et incertitudes énumérés dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris le formulaire 10-K de la société déposé auprès de la SEC le 25 août 2022, vers lequel nous vous renvoyons pour de plus amples informations. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document, et la société n'est pas tenue de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouvelles informations ou de nouveaux événements, sauf si la loi l'exige.

©2023 KIOXIA Corporation ou ses filiales. Tous droits réservés.

©2023 Western Digital Corporation ou ses filiales. Tous droits réservés.

Western Digital, le design Western Digital et le logo Western Digital sont des marques déposées ou des marques commerciales de Western Digital Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

¹ Source : Au 30 mars 2023. Enquête KIOXIA.

À propos de KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH (anciennement Toshiba Memory Europe GmbH) est la filiale européenne de KIOXIA Corporation, un fournisseur mondial de mémoire flash et de disques statiques à semi-conducteurs (SSD). Depuis l'invention de la mémoire flash jusqu'à la technologie révolutionnaire de BiCS FLASH d'aujourd'hui, KIOXIA continue de proposer des solutions et des services de mémoire de pointe qui enrichissent la vie des gens et élargissent les horizons de la société. L'innovante technologie de mémoire flash 3D de KIOXIA, BiCS FLASH, façonne l'avenir du stockage dans des applications à haute densité, notamment les smartphones, les PC, les disques SSD, les centres de données et l'automobile.

Visitez notre [site Web KIOXIA](#)



Coordonnées pour la publication :

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél. : +49 (0)211 368 77-0

Adresse e-mail : KIE-support@kioxia.com

Coordonnées pour les demandes d'information éditoriale :

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tél. : +49 (0) 211 36877 382

Adresse e-mail : lena1.hoffmann@kioxia.com

Émis par :

Birgit Schöniger, Publitek

Téléphone : +49 (0) 4181 968098-13

E-mail : birgit.schoeniger@publitek.com